

中国仪器仪表学会文件

第十一届中国功能材料及其应用学术会议

暨 2024 功能材料国际论坛

会议通知

(第二轮)

(2024 年 05 月 17-20 日, 重庆)

一、会议简介

“中国功能材料及其应用学术会议”(China National Conference on Functional Materials and Applications), 是 1991 年由中国仪器仪表学会仪表材料分会、国家“863”新材料专家委员会、重庆仪表材料研究所等单位共同发起、每三年召开一次的系列会议, 系中国功能材料科技领域中的全国性、综合性的大型学术盛会。旨在促进我国功能材料科技领域中新材料、新技术、新工艺和新产品的研究开发及其推广应用, 促进科研、生产与应用的有机结合, 促进科技成果的产品化、商品化、工程化、产业化与国际化, 以及科技与经济的密切结合, 加快形成新质生产力, 推动我国功能材料的学科繁荣、技术创新与产业发展。

“中国功能材料及其应用学术会议”至今已成功地召开了十届。“第十一届中国功能材料及其应用学术会议暨 2024 功能材料国际论坛”拟定于 2024 年 5 月 17-20 日在重庆召开。会议由国机集团新材料产业协同创新联盟、重庆材料研究院有限公司、中国仪器仪表学会仪表功能材料分会等承办。会议邀请了功能材料

各领域的国内外著名科学家作特邀报告。大会组委会将努力把本届会议办成我国新材料领域的一次层次高、规模大、专业广、国际化的大型学术盛会。

二、组织机构

1. 主办单位

中国仪器仪表学会

国家仪表功能材料工程技术研究中心

2. 承办单位

国机集团新材料产业协同创新联盟

重庆材料研究院有限公司

中国仪器仪表学会仪表功能材料分会

中国仪器仪表行业协会仪表功能材料分会

重庆功能材料学会

3. 协办单位

清华大学 北京大学 厦门大学 武汉理工大学 北京科技大学

复旦大学 中山大学 天津大学 北京工业大学 西北工业大学

中南大学 四川大学 重庆大学 西南大学 哈尔滨工业大学

4. 大会主席

主 席：潘复生院士 陈学东院士

5. 学术委员会

主 席：王中林院士 刘云圻院士

委 员：（以姓氏笔画为序）

王 强 王东哲 王鲁宁 邢 焰 刘永长 刘雪峰 纪荣嵘

李正操 吴玉程 汪瑞军 宋 成 宋克兴 宋晓艳 张劲松

张国庆 张善勇 林元华 林学春 周欢萍 郑明光 赵栋梁

郝晓东 侯仰龙 黄伟九 曾小勤

6. 组织委员会

主 席：张清杰院士 顾 宁院士

委 员：（以姓氏笔画为序）

丁书江 于海峰 马东阁 王金斌 云 峰 邓 旭 卢明辉
代 斌 刘 庄 江慧丰 许并社 李 舟 李 垚 李美成
李 磊 李 璐 杨华明 杨 洪 何 芳 汪 洋 沈国震
张 斗 张进成 张 勇 张 浩 周小元 周益春 官建国
赵远锦 胡季帆 侯向辉 姜 勇 姚亚刚 袁 鹏 倪 文
高 琛 郭胜锋 黄美良 董发勤 董 帆 解孝林 魏大程

三、分论坛主题

(一) 学术论坛主题

分会一、人工智能与高通量计算

分会主席：宋晓艳

承办单位：北京工业大学

分会二、先进磁性功能材料

分会主席：胡季帆、姜 勇

承办单位：山东大学、天津工业大学

分会三、热功能材料

分会主席：卢明辉、姚亚刚

承办单位：南京大学

分会四、传感材料

分会主席：沈国震、李 舟、魏大程

承办单位：复旦大学

分会五、稀土功能材料

分会主席：汪瑞军

承办单位：中国稀土学会铸造合金专委会

分会六、先进金属功能材料

分会主席：宋克兴、王 强

承办单位：河南省科学院

分会七、功能材料制备加工技术

分会主席：刘雪峰、黄伟九、高 琛

承办单位：北京科技大学、重庆文理学院

分会八、矿物功能材料

分会主席：董发勤、倪文、杨华明、袁鹏、边亮

承办单位：西南科技大学

分会九、生物及医用功能材料

分会主席：官建国、刘庄、赵远锦

召集人：牟方志、冯良珠

承办单位：武汉理工大学

分会十、能源功能材料

分会主席：吴玉程、李美成

召集人：姜银珠、崔鹏、刘乐浩、孙鑫

承办单位：华北电力大学

分会十一、纳米材料及技术

分会主席：周小元、董帆、张育新、黄进

召集人：王维朗

承办单位：重庆大学《Nano Materials Science》编辑部

分会十二、先进显示材料及应用

分会主席：解孝林

召集人：马东阁、于海峰、杨洪

承办单位：华中科技大学

分会十三、化合物半导体及器件

分会主席：许并社

召集人：张进成、云峰、王智勇

承办单位：陕西科技大学

分会十四、陶瓷功能材料

分会主席：周益春、张斗

召集人：王金斌、石锋、杨琼、刘岗、杨斌、潘仲彬

承办单位：中南大学

分会十五、超材料与功能复合材料

分会主席：李 垚、邓 旭、孙 宽

召集人：李晓丹、王庆平、赵弘韬、赵 欣、徐洪波、童仲秋

承办单位：哈尔滨工业大学

分会十六、高分子功能材料

分会主席：丁书江、李 璐、邓 华

召集人：周伟东、梁福鑫、柏栋予、张道海、翟福强、陈 煜

承办单位：西安交通大学、重庆文理学院、贵州民族大学

分会十七、碳基功能材料

分会主席：代 斌、史浩飞、侯向辉、李延辉

召集人：魏 忠、于 锋、王 刚

承办单位：石河子大学、新疆兵团绿色化工过程重点实验室

分会十八、高熵合金和非晶材料

分会主席：张 勇、郭胜锋

召集人：姚永刚、马 将、丁 俊、余 鹏、谭 军

承办单位：北京科技大学、西南大学、重庆师范大学、重庆大学

(二) 产业论坛主题

分会十九、航天先进材料

分会主席：邢 焰

承办单位：中国航天先进材料联盟、重庆功能材料学会

分会二十、核电先进材料

分会主席：郑明光

承办单位：核电安全技术与装备全国重点实验室

分会二十一、农机先进材料

分会主席：汪瑞军

承办单位：中国农业机械化科学研究院新材料技术与装备研究所

四、会议征文

1. 征文范围

内容包含但不限于各主题范围、未在国内外正式刊物或其他会议上发表的中

英文论文。

2. 论文要求

(1) 来稿应主题明确，行文流畅，具有创新性、科学性、实用性，数据、结论可信。论文需不涉及国家秘密、商业秘密等保密内容，如出现涉密问题，作者须自行负责。

(2) 来稿请投递 Word 文档（论文模板详见附件：中/英文论文模板），欢迎申请作墙报展示，请备注“申请墙报展示”。

3. 论文出版

(1) 通过专家评审的论文将被收录至会议论文集，会议论文集将不以任何形式公开发表（包括网络发表），仅供会议交流。

(2) 部分优秀中英文论文将被推荐至《IOP Conference Series: Materials Science and Engineering》（SCI 收录）、《Key Engineering Materials》（EI 收录）、《材料导报》（EI 收录）、《表面技术》（EI 收录）、《功能材料》（核心收录），通过期刊正常评审录用后，在正刊发表（期刊正常收取版面费）。

4. 投稿方式及时间节点

投稿方式：大会采用网上投稿系统，请登录官网投稿。

征文截稿日期：2024 年 4 月 10 日

五、会议时间、地点及注册费

1、会议时间：2024 年 5 月 17-20 日

17 日：全天报到

18 日：开幕式、大会特邀报告、分论坛报告

19 日：分论坛报告

20 日：分论坛报告、会议结束、代表离会

2、会议地点：重庆悦来国际会议中心（重庆市渝北区滨江大道 86 号）

3、会议注册费：

类别	2024 年 5 月 8 日前缴费	2024 年 5 月 8 日后缴费
学生	¥1200	¥1800
非学生	¥2200	¥2800

会议注册费可提前支付也可现场缴纳。

汇款账户信息：

开户名称：中国仪器仪表学会

开 户 行：工行北京北新桥支行

行 号：102100000431

汇款账号：0200004309014464348

付款备注：姓名+单位+功能材料大会

4、注册与缴费方式：

请登录大会官网（<https://ncfma2024.scimeeting.cn>）

或扫描下方二维码注册后进行汇款支付。



大会官方二维码

六、联系方式

单 位：重庆材料研究院有限公司（《功能材料》编辑部）

地 址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 8 号

E-mail: gncillq@126.com

联系人电话：

会议咨询：吴国蓁（13650556889）、肖 洁（17723986450）

财务咨询：罗琳青（15123329511）、李 凤（15310690381）

征文咨询：李 峰（18983062661）、陈 东（13983033438）

展览咨询：黄桂春（17783855250）、张 弛（18523160736）

赞助咨询：郑雅文（15923206400）、何伦英（13883104629）

